

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	OMINMATE Data – USB-Buchse, USB Buchsen, 480 MBit/s, SMD-Lötanschluss, 180°, ≥ 10000, Raster in mm (P): 0.65 mm, Polzahl: 5, LCP, schwarz, Tape
Best.-Nr.	2762070000
Typ	USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK
GTIN (EAN)	4064675035299
VPE	2.000 Stück
Verpackung	Tape

Erstellungs-Datum 29. April 2024 03:25:02 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2,9 mm	Tiefe (inch)	0,114 inch
Höhe	10,51 mm	Höhe (inch)	0,414 inch
Breite	7,99 mm	Breite (inch)	0,315 inch
Nettogewicht	0,299 g		

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	<25 mΩ	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Nennspannung	48 V	Nennstrom	1 A
Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt	100 V AC		

Systemkennwerte

Abgangswinkel	180°	Anschlussart	Buchse
LED	Nein	Leistungs-Kategorie	480 MBit/s
Lötstift-Abmessungen	oktogonal	Lötstiftlänge (l)	0 mm
Lötstiftposition-Toleranz	± 0,1 mm	Lötverfahren	Reflow-Löten, Handlöten
Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss	Polzahl	5
Produktfamilie	OMINMATE Data – USB-Buchse	Raster in Zoll (P)	0,026 "
Raster in mm (P)	0,65 mm	Schirmmaterial	Edelstahl
Schirmoberfläche	vernickelt	Schirmung	Ja
Schutzart	IP20	Steckkraft/Pol, max.	35 N
Steckzyklen	≥ 10000	Ziehkraft/Pol, min.	10 N
Übertragungsrate	480 MBit/s		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Kontaktbasismaterial	Kupferlegierung	Kontaktmaterial	Cu-leg
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel	Schichtaufbau - Steckkontakt	≤ 1 μ" Au
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	70 °C
Betriebstemperatur, min.	-30 °C	Betriebstemperatur, max.	80 °C

Verpackungen

Verpackung	Tape	VPE Länge	462 mm
VPE Breite	450 mm	VPE Höhe	166 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Produktänderungsmitteilung	Änderung der Verpackung – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK Change of packaging – 2762070000 USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Datenblatt

USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

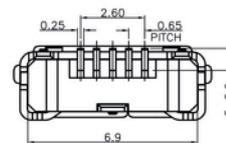
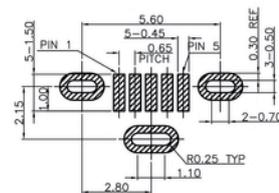
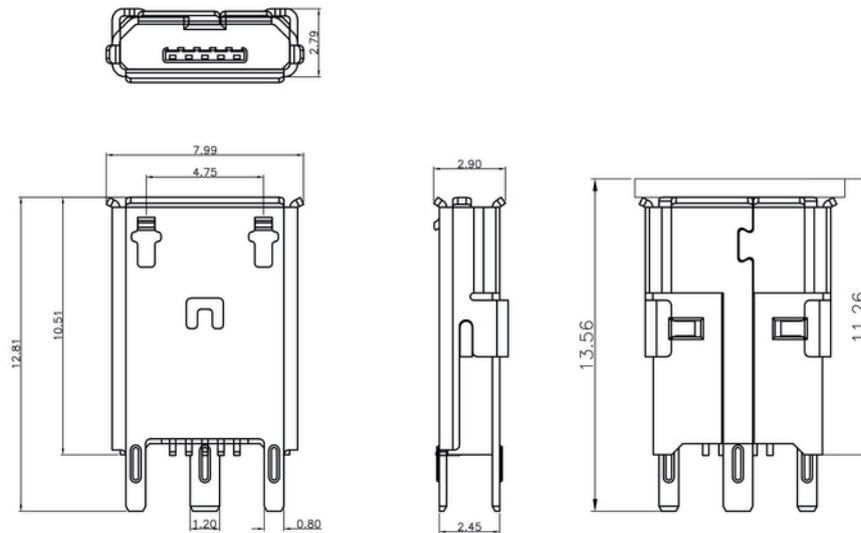


USB-MIC2.0B S1V 1N1 RL BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

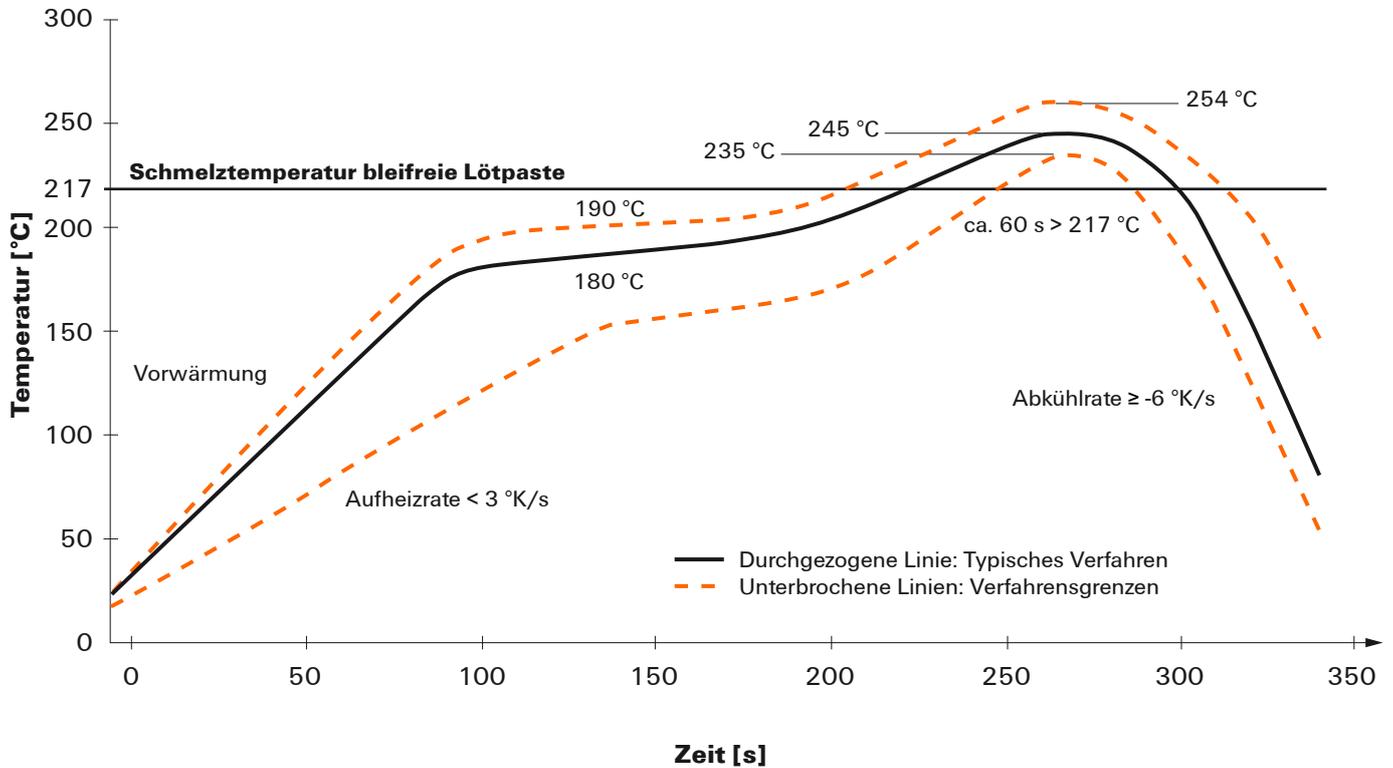
www.weidmueller.com



RECOMMEND PCB LAYOUT (THICKNESS=1.6mm)
TOLERANCE: ±0.05

Empfohlenes Reflow-Lötprofil

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt $\leq +3 \text{ K/s}$. Parallel dazu wird die Lotpaste ‚aktiviert‘. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei $\ge -6 \text{ K/s}$ härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.